

<<木质粉末温压成形原理与技术>>

图书基本信息

书名：<<木质粉末温压成形原理与技术>>

13位ISBN编号：9787566701275

10位ISBN编号：7566701274

出版时间：2012-1

出版时间：湖南大学出版社

作者：吴庆定

页数：254

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<木质粉末温压成形原理与技术>>

内容概要

《木质粉末温压成形原理与技术》为中南林业科技大学机械制造及其自动化学科带头人吴庆定教授在国家自然科学基金项目（30972305）和湖南省高等学校科学研究重点项目（D9A101）的资助下，以本人博士论文为基础，综合多年从事粉末冶金、木材科学与技术、机械工程等多学科教学与科研成果撰写而成的。

全书共分十章，主要包括木质粉末温压成形工艺、模具设计、数值模拟、结合机理、环境友好性评估和应用研究等内容。

本书可作为材料学、木材科学与技术、材料加工工程等学科研究生教材或参考书。也可供生物质功能材料、机械工程材料等领域科研与工程技术人员参考。

<<木质粉末温压成形原理与技术>>

书籍目录

第1章 绪论1.1 木质材料的热压与模压成形1.1.1 木质材料的热压成形1.1.2 木质材料的模压成形1.1.3 木质材料干法无胶热压成形1.2 金属粉末温压成形1.2.1 温成形的基本概念1.2.2 金属粉末温压成形1.2.3 金属粉末温压成形的特点、致密化机理与启示1.3 木质粉末温压成形研究的意义与现状1.3.1 木质粉末温压成形的提出1.3.2 木质粉末温压成形研究的意义1.3.3 木质粉末温压成形研究的现状与前景1.4 木质粉末温压成形理论与技术的研究方法1.4.1 热脱附—气相色谱 / 质谱分析法(TD—GC / MS)1.4.2 超景深三维立体数码显微镜法(3DSDDM)1.4.3 场发射扫描电子显微镜法1.4.4 热失重分析法(TGA)1.4.5 红外光谱分析法(FTIR)1.4.6 核磁共振光谱分析法(NMR)1.4.7 体积电阻四探针测量法参考文献第2章 温压成形木质粉末原料第3章 木质粉末无胶温压成形工艺第4章 木质粉末温压成形模具设计第5章 木质粉末无胶温压成形过程的数值模拟第6章 木质粉末原料的TD-GC/MS分析第7章 木质粉末无胶温压成形结合机理……第10章 木质粉末温压成形技术要点与前景展望

<<木质粉末温压成形原理与技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>